

证券代码：002214

证券简称：大立科技

公告编号：2019—038

浙江大立科技股份有限公司

关于新产品研发进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

公司 $12\mu\text{m}$ 像元、 3072×2048 规格 600 万像素非制冷红外焦平面探测器样品已经过公司研制评审环节确定研发成功，其关键技术验证在公司内部进行，属于企业自检结果，且该产品尚未取得客户认证和正式订单，尚未形成量产和对外销售，不会对公司当期业绩产生较大影响，对公司未来业绩影响程度尚无法预测，同时，未来的市场需求、市场拓展及竞争情况具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日成功研制出 $12\mu\text{m}$ 像元、 3072×2048 规格 600 万像素非制冷红外焦平面探测器，具体情况如下：

一、新产品研发概要及进展

红外焦平面探测器是热成像系统的核心部件，是探测、识别和分析物体红外信息的关键。非制冷红外焦平面探测器是以微机电技术（MEMS）制备的热传感器为基础，将物体红外热辐射信号转换成可供人眼视觉分辨的图像的高技术产品，是红外热成像系统的核心和难点。

自 2018 年起，公司在 $15\mu\text{m}$ 像元、200 万像素非制冷红外探测器技术的基础上，开始了 $12\mu\text{m}$ 像元、600 万像素产品的研发。近期，600 万像素面阵产品样品已经过公司研制评审环节确认研发成功，并将于近期提交与该产品相关的集成电路布图保护及设计专利申请。据公开信息，这是业内首款达到 600 万像素级的非制冷红外焦平面探测器产品。

该探测器采用非晶硅技术路线，像元中心距 $12\mu\text{m}$ ，集成 600 万像素面阵，产品保持了非晶硅技术路线大面阵、高均匀性和高稳定的特点。目前，市场上高分辨率非制冷红外探测器产品水平多为 1280×1024 既 100 万像素面阵，更大面阵的非晶硅红外探测器可提供更高速、更细腻红外图像，满足高动态、大视场的应用需求，适用于航空航天、空间遥感、态势感知等高端应用场景。

二、对公司的影响

公司 600 万像素面阵非制冷红外焦平面探测器研发成功，但尚未取得客户认证和正式订单，尚未形成量产和对外销售，短期内不会对公司生产经营产生重大影响。公司在 200 万像素非制冷红外探测器技术的基础上进一步成功研制出 600 万像素面阵产品，巩固了公司在高分辨率非制冷红外探测器领域的领先地位，有利于增强公司核心竞争力，将对公司的长期发展战略产生一定影响。

三、风险提示

1、公司本次 600 万像素面阵产品关键技术验证在公司内部进行，属于企业自检结果，公司尚未聘请第三方鉴定机构鉴定或公证；

2、目前该产品样品已经研发成功，尚需经过设计定型评审、首批生产评审及生产定型评审环节，产品尚未取得客户认证和正式订单，尚未形成量产和对外销售，不会对公司当期业绩产生较大影响，对公司未来业绩影响程度尚无法预测；

3、目前市场上高分辨率非制冷红外探测器产品水平多为 1280×1024 既 100 万像素面阵，600 万像素面阵产品尚处于研发阶段，未来的市场需求、市场拓展及竞争情况具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 董事会

二〇一九年八月二十三日